

Schall macht Messen für Märkte! Schall makes trade fairs for markets!

Bondexpo



6. Bondexpo – Die Fachmesse für industrielle Klebtechnologie

6th Bondexpo – The Trade Fair for Industrial Bonding Technology

08.-11. OKTOBER 2012 · STUTTGART
www.bondexpo-messe.de

BONDexpo – Fügen und Verbinden durch Kleben

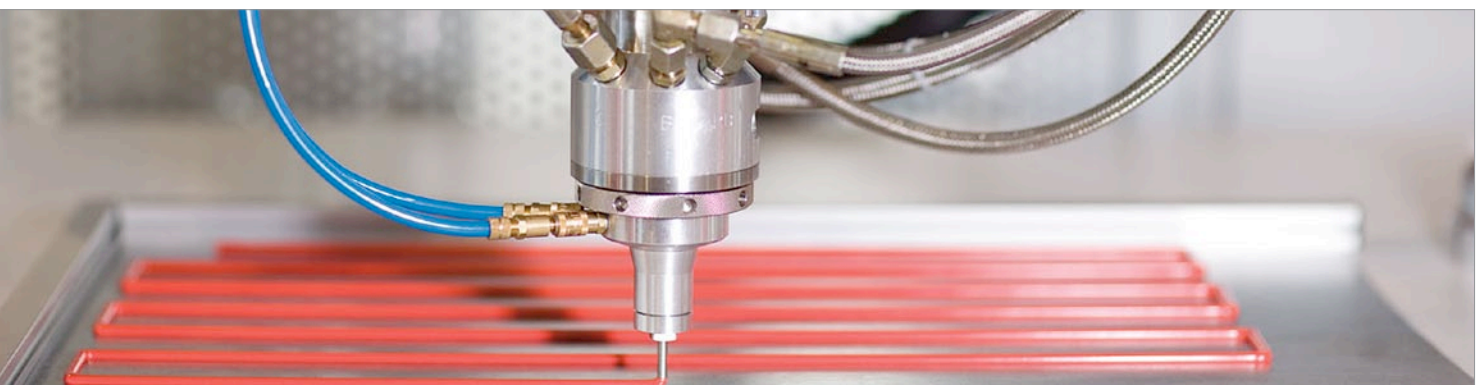
Mit der BONDexpo – Die Fachmesse für industrielle Klebtechnologie – hat das private Messeunternehmen Schall einen neuen Typus Branchen- und Anwender-treff entwickelt, der sich zur 5. Veranstaltung im Herbst 2011 als bestens etabliert zeigte. Zur letzten BONDexpo in Stuttgart waren mit 106 Ausstellern aus 9 Nationen, 3.800 m² Ausstellungsfläche, einer Steigerung der Fachbesucheranzahl um 17% und einem mit 24% sehr hohen Anteil an ausländischen Ausstellern, Bestmarken zu verzeichnen. Damit avancierte die BONDexpo in nur wenigen Jahren zum weltweiten Branchen- und Anwender-

treff Nr.1! Mit der klaren und konsequenten Ausrichtung auf die Prozesskette Fügen/Verbinden durch Kleben, Vergießen, Dichten und Schäumen werden für die aktuellen und künftigen Problemstellungen in den Bereichen Fügen und Verbinden von konventionellen sowie vor allem modernen Materialien wirtschaftliche Detail- und Systemlösungen offeriert. Dies bezieht sich nicht zuletzt auf neue Anforderungen hinsichtlich Ressourcenschonung und Material- sowie Energieeffizienz durch Materialmix-/Hybridkonstruktionen für den Leichtbau oder die Miniaturisierung für mikrosystemtechnische Anwendungen.

BONDexpo – gut geklebt ist halb montiert

Das innovative Fachmessen-Konzept der BONDexpo plus die zeitliche Anbindung an die MOTEK Internationale Fachmesse für Montage, Handhabungstechnik und Automation münden in einem komplementären Fachmessen-Duo, das die gesamte Prozesskette der Produktions- und Montage-Automatisierung inklusive der elementaren Verbindungs- und Fügetechnik durch Kleben darstellt. Diese absolut praxisnahe Kombination ist weltweit einmalig und findet am international anerkannten Fachmessen-Standort Stuttgart maximale Akzeptanz. Zumal die komplexe Thematik Klebstoffe etc. und das Dosieren und Auftragen derselben nicht isoliert, sondern im produktionstechnischen Zusammenhang präsentiert

werden. Damit unterscheidet sich die BONDexpo völlig von den konventionellen polytechnischen Fachmessen für herkömmliche thermisch-mechanische Füge- und Verbindungsverfahren. Schließlich eignen sich die Klebe-, Vergieß-, Dicht- und Schäumverfahren auch bestens für eine hochautomatisierte Verarbeitung per Handling- und Robotersystemen, wie sie an der MOTEK in allen Ausprägungen vorzufinden sind. Die im Jahr 2012 vom 8. bis 11. Oktober zum 6. Mal stattfindende BONDexpo, bietet Ihnen und Ihrem Unternehmen die Chance, sich im passenden Umfeld dem Fachpublikum aus der globalisierten Produktionswelt vorstellen zu können.



BONDexpo – Joining and Fastening by means of Bonding

With the BONDexpo trade fair for industrial bonding technology, private trade fair promoters P.E. Schall GmbH & Co. KG have developed a new style of industry and user meeting place which demonstrated just how well it has become established at its fifth event in the fall of 2011. The last BONDexpo in Stuttgart received top scores with 106 exhibitors from 9 countries, 41,000 square feet of exhibition floor space, a 17% increase in expert visitor numbers and a very high percentage of exhibitors from outside of Germany (24%). And thus in just a few years, BONDexpo has evolved into the world's number one industry and user meeting place! With its clear-cut

and consistent alignment towards the joining/fastening process sequence by means of bonding, encapsulation, sealing and foaming, economical detail and system solutions are offered for current and future tasks in the areas of joining and fastening of conventional and above all modern materials. Not least of all, this addresses new requirements with regard to the conservation of resources and efficient use of materials and energy by means of a good material mix and hybrid designs for lightweight engineering, as well as miniaturisation for microsystems applications.

BONDexpo – Well Bonded is Half Assembled

The innovative trade fair concept for BONDexpo, plus concurrence with the MOTEK international trade fair for handling, assembly and automation technology, has created a complementary trade fair duo which presents the entire process sequence for production and assembly automation, including the primary fastening and joining technology of bonding. This highly practical combination is unique throughout the world and is extremely well received by the international venue for technical trade fairs in Stuttgart – especially in light of the fact, that the issues of adhesives etc., as well as metering and application of these materials, are not isolated, but rather presented

within the context of production technology. This fully distinguishes BONDexpo from the usual multi-technology trade fairs for conventional thermo-mechanical joining and fastening processes. After all, bonding, encapsulating, sealing and foaming are also very well suited for highly automated processing with handling and robot systems, as presented in all possible variants at MOTEK. BONDexpo, which will take place for the sixth time in 2012 from the 8th through the 11th of October, provides you with the opportunity of presenting your company to expert visitors from the globalised world of production in an appropriate setting.



Ausstellungsprogramm (Kurzübersicht)

Exhibition program (short survey)

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ▪ Rohstoffe für Kleb- und Dichtstoffe | ▪ Maschinen, Anlagen und Zubehör für die klebstoff-
verarbeitende Industrie | ▪ raw materials for adhesives and sealants | ▪ machinery, equipment and accessories for the adhesives processing industry |
| ▪ Maschinen, Anlagen und Zubehör für die klebstoff-
herstellende Industrie | ▪ Prüf- und Messtechnik | ▪ machinery, equipment and accessories for the adhesives manu-
facturing industry | ▪ measuring and test technology |
| ▪ Kleb- und Dichtstoffe | ▪ Dienstleistungen | ▪ adhesives and sealants | ▪ services |

Zahlen ▪ Daten ▪ Fakten ▪ 5. Bondexpo 2011 Facts and Figures 5th Bondexpo 2011

- | | |
|---|--------------------------|
| ▪ Zyklus Cycle | jährlich annually |
| ▪ Aussteller / Länder Exhibitors / Countries | 106 / 9 |
| ▪ Anzahl Inland / Ausland Number of Inland / Foreign Country | 81 / 25 |
| ▪ Fläche brutto (in m²) Area gross (in sqm) | 3.800 |
| ▪ Besucher / Länder (inkl. Motek) Visitors / Countries (incl. Motek) | 36.852 / 96 |

Zeitgleich finden statt Parallel events



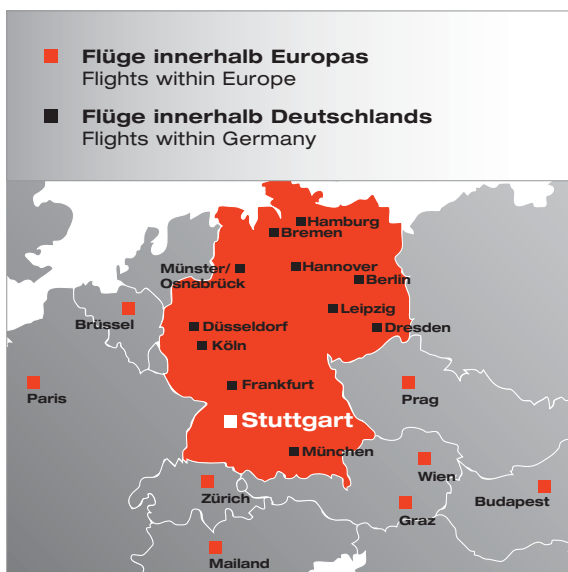
31. Motek - Die Internationale Fachmesse für Montage-, Handhabungstechnik und Automation

31st Motek - The International Trade Fair for Assembly, Handling Technology and Automation



5. Microsys - Fachmesse für Mikro- und Nanotechnik in der Entwicklung, Produktion und Anwendung

5th Microsys - Trade Fair for Micro- and Nanotechnology in R&D, Production and Application Engineering



Veranstalter Organizer:

P.E. Schall GmbH & Co. KG
 Gustav-Werner-Straße 6 ▪ D - 72636 Frickenhausen
 T +49 (0) 7025 9206-0 ▪ F +49 (0) 7025 9206-620
www.schall-messen.de